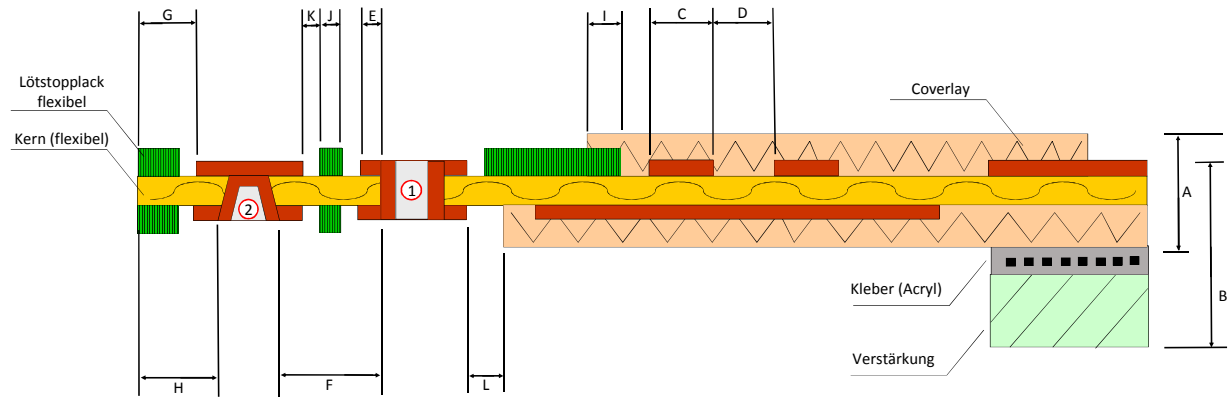


ILFA Designregeln für ein- und doppelseitige, flexible Leiterplatten



ILFA Leiterplatten:

Allgemeine Designregeln

Max. Leiterplatten Maße

Dicke flexibler Bereich über alles

Dicke verstärkter Bereich Steckverbinder

	LEGENDE	STANDARD	HIGH END (AUF ANFRAGE)
A		420x570mm ≥0.065 mm (einseitig) , ≥0.10 mm (doppelseitig)	auf Anfrage
B		≥0.10 mm - 0.50 mm , Toleranz +/- 30 µm ≥ 0.50 mm , Toleranz +/- 10%	auf Anfrage

Metallisierte Bohrungen & Fräsungen (Angaben beziehen sich auf den Bohrerwerkzeugdurchmesser)

Bohrerwerkzeugdurchmesser

Durchgangsbohrung

Blind Via (von oben, oder unten)

		STANDARD	HIGH END (AUF ANFRAGE)
		Vorgegebener Enddurchmesser + 100 µm	auf Anfrage
1		Aspekt Ratio 1:8, kleinster Ø 75 µm	Aspekt Ratio 1:10, kleinster Ø 50 µm
2		Aspekt Ratio 1:1, kleinster Ø 75 µm	Aspekt Ratio 1:1,2, kleinster Ø 50 µm

Leiterbild / Restringe

Leiterbreite min. (µm)

abhängig von Kupferstärke

C ≥75

≥50

Leiterabstand min. (µm)

abhängig von Kupferstärke

D ≥75

≥50

Umlfd. Restring zum Bohrerwerkzeug-Ø (µm)

E ≥100

≥75

Abstand Bohrung zu Bohrung (µm)¹

bezgl. auf Bohrerwerkzeug-Ø

F ≥100

≥100

Abstand Leiterbild zu Fräskontur (µm)

G ≥300

≥100

Abstand Bohrung zu Fräskontur (µm)

bezgl. auf Bohrerwerkzeug-Ø

H ≥350

≥200

Überlappung Coverlay und Lack (µm)

nur bei Kombivariante

I 300

auf Anfrage

Lötstopplack / Coverlay

Lackstegbreite (µm)

bei Lackdicke ≤ 50 µm

J ≥100

auf Anfrage

Lackfreihaltung zum Kupfer (µm)

K ≥50

≥25

Coverlayfreihaltung zum Kupfer (µm)

L ≥150

≥100

Materialdicken (µm)

Dicke Flexibles Polyimid (kleberlos)

bevorzugt mit Walzkupfer

Dicke: 25 - 150, Kupfer: 12 - 35

Kupfer: 9 ED-Kupfer, o. Kupfer ≥70

Dicke Coverlay

DuPont FR o. LF (bevorzugt FR)

25, 38, 50, 75, 100, 150

Dicke Acrylkleber für Verstärkung (therm. härtend)

DuPont FR o. LF (bevorzugt FR)

25, 50, 75

Dicke Acrylkleber für Verstärkung (Transferkleber)

3M Transferkleber

50 o. 130

Dicke Verstärkung

FR4 oder Coverlay

Coverlay 25 - 150, FR4 50 - 3200

Biegen

Minimaler Biegeradius² einmalige Biegung (mm)

Coverlay

Dicke des flexiblen Bereichs X 1

auf Anfrage

Minimaler Biegeradius² 4-12 Zyklen (mm)

Coverlay

Dicke des flexiblen Bereichs X 6

auf Anfrage

Minimaler Biegeradius² dyn. Beanspruchung (mm)

Coverlay

Dicke des flexiblen Bereichs X ≥ 10

auf Anfrage

Minimaler Biegeradius 4-12 Zyklen (mm)

flexibler Lötstopplack

≥ 1,50 mm

auf Anfrage

Weitere Optionen sind möglich: Ihr Lageraufbau entspricht nicht dem Standard? Wir helfen gerne weiter.

¹Abstand Bohrung zu Bohrung: Das Maß bezieht sich auf den Abstand zw. Bohrungen mit gleichem elektrischen Potential. Das Mindestmaß für Bohrungen mit unterschiedlichen Potentialen ergibt sich aus dem minimalen umlfd. Restring und dem minimalen Leiterabstand.

²Biegeradius: Dicke des flexiblen Bereichs = Addition aller Materialien (Coverlay, Kleber, Kupfer, Basismaterial). Die Angaben gelten nur für einen flexiblen Kern mit max. zwei Kupferlagen.

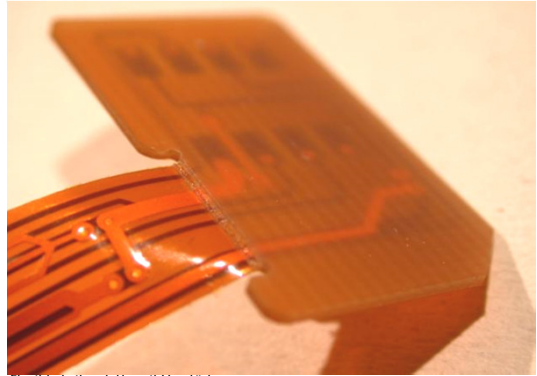
ILFA Designregeln für ein- und doppelseitige, flexible Leiterplatten

Beispiele flexibler Leiterplatten

Verstärkungen

Um eine Bestückung zu vereinfachen, oder eine zuverlässige Steckverbindung zu ermöglichen, werden flexible Leiterplatten häufig verstärkt.

Die flexiblen Leiterplatten können partiell mit einer Verstärkung versehen werden. Je nach Stückzahl und Layout können zwei Klebevarianten verwendet werden. Die kalte Variante mittels Transferkleber, bei der die Verstärkungen manuell mit Hilfe eines Adapters aufgebracht werden, hat sich bei geringen Stückzahlen und kleinen Verstärkungsbereichen bewährt. Bei großflächigen Verstärkungen, bzw. hohen Stückzahlen findet eine Aufbringung durch Heißlamination statt.

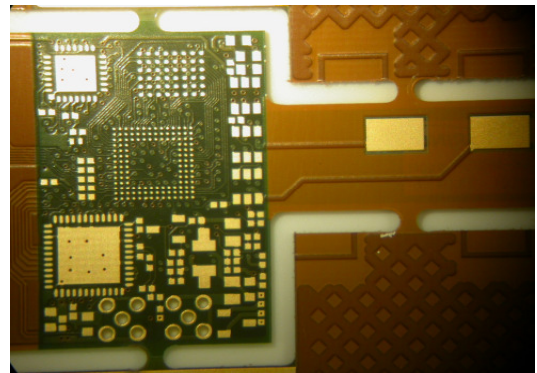


Flexible Leiterplatte mit Verstärkung

Flexibler Lötstopplack und/oder Coverlay

Zur Isolation der außen liegenden Leiter kann flexibler Lötstopplack und/oder Coverlay verwendet werden. Der flexible Lack ist die LowCost-Variante, ist weniger flexibel als Coverlay, bietet aber durch die fotolitographische Strukturierung den Vorteil, dass eine kleine Freihaltung um freizustellende Strukturen ausreicht. So können Lackstege auch zwischen FinePitch Bauteilen realisiert werden.

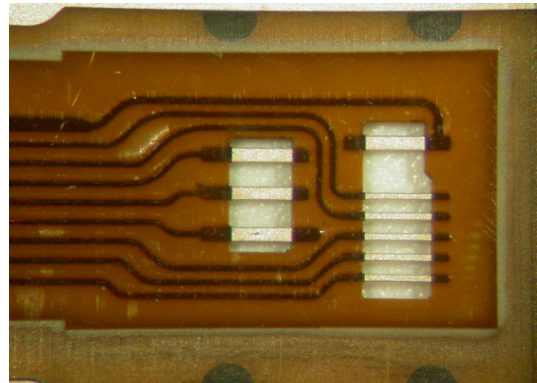
Wenn es um hohe Flexibilität und dynamische Biegebeanspruchungen geht, ist Coverlay die erste Wahl. Dieses wird lasertechnisch vorstrukturiert und in einem Laminationsschritt aufgebracht. Da bei diesem Prozess größere Toleranzen als beim Lack auftreten, wird häufig die Kombinationsvariante verwendet. Im Bestückungsbereich der fotostrukturierbare Lack, und im Biegebereich der hochflexible Verbund aus Polyimid und Acrylatkleber, das sogenannte Coverlay. Ein Überlappungsbereich muss vorgesehen werden (siehe



Flexible Leiterplatte mit Kombinationsvariante Lack und Coverlay

Flying Leads (auch Floating Leads)

Eine Sondertechnologie sind sogenannte Flying Leads. Das Kupfer der Leiter wird in Teilbereichen beidseitig von Basismaterial freigestellt. Dies wird durch Laserablation erreicht. Die flexible Leiterplatte lässt sich dann von oben auf eine starre Leiterplatte, oder ein Bauteil auflöten.



Flexible Leiterplatte mit Flying Leads